

2025年3月期 第2四半期 決算説明会 Q&A

■ 質問一覧

- Q1 説明会の資料（p.13）ではCY2025のWFEについて前回の想定と変化はないが、アプリケーション別など何らかの変化があるか？
- Q2 CY2025の中国のWFEについてどのように考えているか教えてほしい。
- Q3 CY2025のWFEは政府の中国への規制の影響をどのように織り込んでいるか？
- Q4 FY2025の売上高予想を1,000億円上方修正しているが、その理由をアプリケーション別に、またどの地域が牽引したか教えてほしい。
- Q5 FY2025 Q1比でQ2の売上総利益率が下がった理由は？
- Q6 FY2026の新規装置売上において牽引役となる製品は何か？それぞれの製品の成長について教えてほしい。
- Q7 一般的には中国売上構成比率が下がると利益率は下がる傾向だが、御社のFY2025下期の売上総利益率が上がる要因を教えてほしい。FY2026はさらに売上総利益率が上がるか？
- Q8 フィールドソリューションについて。FY2025 Q2売上は四半期ベースで過去最高となったが、大幅に増収となった理由を教えてほしい。またFY2025 Q3、Q4およびFY2026の見通し、中国の見通しについても教えてほしい。
- Q9 極低温エッチングのPORについて、「著しい進展」というのはどのような進展があったのか、FY2026の売上規模はどれくらいを期待してよいか？
- Q10 ASMLがCY2025の目線を少し下方修正しているが、コータ/デベロッパへの影響を教えてほしい。
- Q11 2024年2月の決算説明会で、研究開発費を1.5倍、設備投資、人材採用も大幅に増強するという話があった。一方、本日の説明会ではTechInsightsのデータを引用し、より力強い伸びを見込んだフォーキャストを出していたが、さらに上の投資水準が必要と考えているか？
- Q12 自社株買いについて、期初に800億円、今回700億円と文字どおり機動的に実施することを発表された。今期2度目の自社株買いを決定した背景と、来期以降の考え方について教えてほしい。



■ Q&A

Q1 説明会の資料 (p.13) では CY2025 の WFE *¹ について前回の想定と変化はないが、アプリケーション別など何らかの変化があるか？

A1 二桁成長との見方は変わっていない。ロジック/ファウンドリ向け投資は引き続き堅調であり今年と同程度の規模が期待できる。一方、メモリは特に HBM *² 用途の DRAM 向け投資が増えていく。NAND は DRAM に比べると市場は小さいが、倍増という見込みは変わっていない。ロジック/ファウンドリとメモリの投資比率については、CY2024 は 7:3、CY2025 はメモリが増え 6:4 となる。

[▲Top](#)

Q2 CY2025 の中国の WFE についてどのように考えているか教えてほしい。

A2 FY2025 下期の当社の中国売上構成比率は 40%を切ると想定している。CY2025 の WFE における中国比率は 30%程度に低下すると見ている。先端向けの投資が増えること、ならびに中国における新興顧客が歩留まり改善活動に注力し新規投資が一服することが理由。実額ベースでは二桁減と想定。

[▲Top](#)

Q3 CY2025 の WFE は政府の中国への規制の影響をどのように織り込んでいるか？

A3 現在想定できるものは織り込んでいる。政府の規制や地政学的動向は、これまで通り今後も注視していく。

[▲Top](#)

Q4 FY2025 の売上高予想を 1,000 億円上方修正しているが、その理由をアプリケーション別に、またどの地域が牽引したか教えてほしい。

A4 上方修正の要因となったのは先端向けと成熟向けで、それぞれ同程度の寄与度。先端ロジック/ファウンドリにおいては追加引き合いが来ている一方で、一部顧客の投資見直しも織り込んでいる。地域別では台湾が牽引。その他、韓国や中国の顧客の投資増額により上方修正につながった。

[▲Top](#)

Q5 FY2025 Q1 比で Q2 の売上総利益率が下がった理由は？

A5 売上総利益率が比較的高い製品の比率が下がった。それに加えて在庫廃棄のために一過性の費用処理をおこなったことが主な要因。

[▲Top](#)



Q6 FY2026 の新規装置売上において牽引役となる製品は何か？それぞれの製品の成長について教えてください。

A6 おかげさまで当社の製品は全て成長している。TechInsights の資料ページ（説明会資料 p.15）が示すとおり、ボリュームゾーンである WFE の中に含まれるコータ/デベロッパ、エッチング、成膜、洗浄の製品群が伸びている。アプリケーション別で見ると、HBM や DDR5 向け DRAM、また AI 向け先端ロジック/ファウンドリが伸びている。エッチングは、GAA^{*3} 向けの投資が既に始まっており、CY2026 は 2nm 世代の投資が本格化。コータ/デベロッパは高いシェアのもと、引き続き堅調に推移。成膜も順調に POR 獲得。WFE 市場に比べるとまだ小さいが、Test/Assembly 市場も非常に伸びており、ボンダーとプローバの売上は前期比 2 倍程度、成長している。CY2025 においてはこれらの先端向け投資のみで当社の売上の 70%ほどを占め、説明会資料に記載した全ての開発アイテムが当社の成長ポテンシャル。

[▲Top](#)

Q7 一般的には中国売上構成比率が下がると利益率は下がる傾向だが、御社の FY2025 下期の売上総利益率が上がる要因を教えてください。FY2026 はさらに売上総利益率が上がるか？

A7 FY2025 下期は先端顧客の投資が伸び、FY2026 には 2nm 向け投資も本格的になる。最先端世代向けの製品は付加価値が高く、当社の優位性が認められ利益率が上昇しており、中国の比率は下がっても売上総利益率は上がる。

[▲Top](#)

Q8 フィールドソリューションについて。FY2025 Q2 売上は四半期ベースで過去最高となったが、大幅に増収となった理由を教えてください。また FY2025 Q3、Q4 および FY2026 の見通し、中国の見通しについても教えてください。

A8 顧客工場の稼働率は向上しており、それに伴うフィールドソリューション売上が順調に進捗。インストールベースも増えており、パーツ/サービス売上が増加している。FY2026 においても顧客稼働率はさらに改善することを想定しているもののガイダンスは公表していないため、成長率についてはコメントを差し控える。CY2023 から多額の投資をおこなっている中国の新興顧客は、現在歩留まり改善に注力されており、稼働率はそれほど高くない。

[▲Top](#)

Q9 極低温エッチングの POR^{*4} について、「著しい進展」というのはどのような進展があったのか、FY2026 の売上規模はどれくらいを期待してよいか？

A9 開発 POR は複数社で獲得しているが、先行している顧客においては最終的な評価段階に移行した。売上規模についてコメントを控えるが、相応の売上貢献が始まるのは CY2026、市場の規模としては CY2027 に \$2B 程度を想定している。

[▲Top](#)



Q10 ASMLがCY2025の目線を少し下方修正しているが、コータ/デベロッパへの影響を教えてください。

A10 CY2025におけるWFEの成長を牽引するのはDRAMとNAND。特にDRAMは微細化が進展しており、EUVだけではなく既存のArF液浸も非常に伸びている。市場成長とともに売上の伸長を想定している。

[▲Top](#)

Q11 2024年2月の決算説明会で、研究開発費を1.5倍、設備投資、人材採用も大幅に増強するという話があった。一方、本日の説明会ではTechInsightsのデータを引用し、より力強い伸びを見込んだフォーキャストを出していたが、さらに上の投資水準が必要と考えているか？

A11 半導体製造技術は技術革新のスピードが速く、当社が世界をリードする技術力を持ち続けることが重要。WFEにおけるAI向け比率が高まる中、当社のSAM^{*5}を拡大するようなビジネス機会も増えている。定量的にはコメントを控えるが、さらに投資が必要になるということも想定し計画を立てている。

[▲Top](#)

Q12 自社株買いについて、期初に800億円、今回700億円と文字どおり機動的に実施することを発表された。今期2度目の自社株買いを決定した背景と、来期以降の考え方について教えてください。

A12 市場動向や当社の成長ポテンシャル、FY2026以降のキャッシュ創出力を総合的に勘案し判断した。今後も適切なバランスシートマネジメントをおこない、ROE30%以上を常に目指していく。

[▲Top](#)

*1 WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体前工程製造装置。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

*2 HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅メモリ

*3 GAA (Gate All Around) : トランジスタのチャネル全面をゲートで覆った構造

*4 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*5 SAM : Served Available Market

FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。

FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

本内容は質疑応答のサマリーです。